

焊接技术文件

Welding Technique

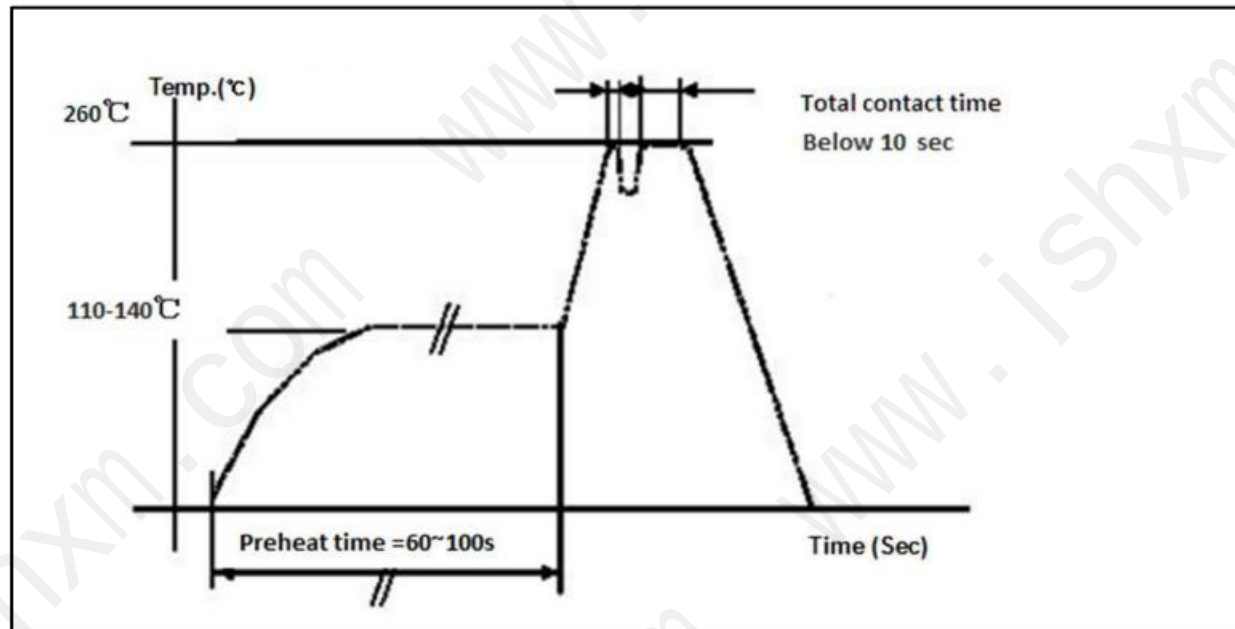
Appendix附录

Recommended Soldering Profile for Rectifier Diodes (Pb Free)

整流二极管的推荐焊接曲线（无铅）

a) Wave Soldering Profile

a) 波峰焊曲线



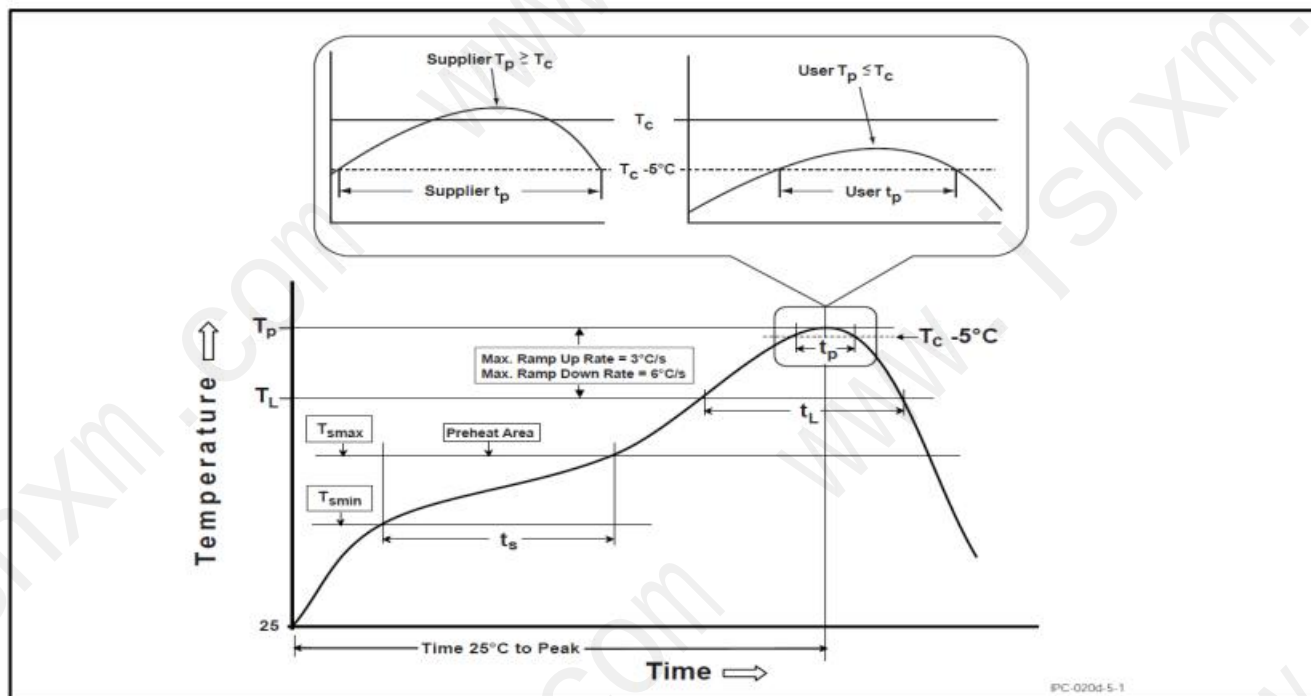
Appendix附录

Recommended Soldering Profile for Rectifier Diodes (Pb Free)

整流二极管的推荐焊接曲线 (无铅)

b) Reflow Soldering Profile (Pb free Application), refer to IPC/JEDEC J-STD-020

b) 回流焊曲线 (无铅应用), 参见 IPC/JEDEC J-STD-020



Appendix附录

Recommended Soldering Profile for Rectifier Diodes (Pb Free)

整流二极管的推荐焊接曲线（无铅）

Preheat/Soak Temperature Min (T _{smin}) Temperature Max (T _{smax}) Time (ts) from (T _{smin} to T _{smax}) 预热/浸泡温度 最小值 (T _{smin}) 最高温度 (T _{smax}) 时间 (ts) 从 (T _{smin} 到 T _{smax})	50 °C 200 °C 60-120 seconds 50 °C 200 °C 60-120 秒
Melting Point of Solder (Sn Ag Cu) 焊料熔点 (Sn Ag Cu)	217°C
Ramp-up Rate to 217°C(Melting Point of Solder) 升温速率至 217°C (焊料熔点)	3°C/sec 3°C/sec
Time at Temp.>217°C (Melting Point of Solder) 温度时间>217°C (焊料熔点)	60~150 Sec 60~150 秒
Peak Temperature 峰值温度	255±5°C
Time within 5°Cbelow Peak Temp. 时间在峰值温度以下 5°C 以内。	20~40 Sec 20~40 秒
Cooling Rate 冷却速率	6°C/sec (max) 6°C/秒 (最大值)
Time from 25°C to Peak Temp. 从 25°C 到峰值温度的时间	8min (max) 8 分钟 (最大)

MHCHXM[®]
Inspiring Power